

数字气压传感器模块手动焊接指南

前言

我们向您提供的数字气压传感器模块，是一款温度敏感电子器件，为确保在后续组装加工过程中，不对模块造成损坏或改变性能参数，请遵从我们的建议，进行焊接操作。

焊接方式

不建议使用回流焊，推荐使用手动焊接。

焊接工具的选择

在我们的焊接试验和客户使用反馈中，我们没有发现使用开放式烙铁（无闭环温度控制的普通烙铁），对焊接或产品性能造成明显影响，但基于无铅焊接的品质要求和提高焊接生产率的需要，我们推荐您使用有闭环温度控制的恒温烙铁，并选用合适烙铁头。客户的使用反馈中显示，尺寸粗大的烙铁头会明显降低焊接效率，增加短路的机会。



焊接材料的选择

我们向您提供的数字气压传感器模块，是完全符合环保无铅要求的绿色产品，我们建议您在焊接中使用符合环保要求的无铅焊锡。我们推荐以下两种合金成份的焊锡，配合免清洗松香

（线芯或外加松香）：

——Sn96.5%/Ag3.0%/Cu0.5%

——Sn96.5%/Ag3.5%

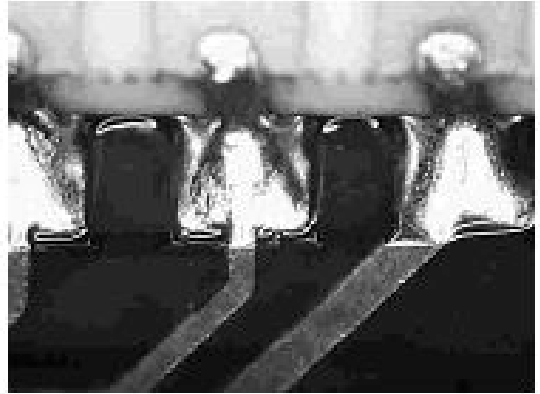


焊接条件及注意事项

如果焊接中具备测量实际焊接温度的条件，我们建议您将实际焊接温度控制在260℃以下；如果您不具备测试实际焊接温度的条件，我们建议您将焊接烙铁的设置温度，设置在340℃以下。

在焊接操作中，我们提请注意以下事项：

1. 让熟练的操作员执行焊接任务缩短焊接时间，降低损坏模块的可能性；
2. 在使用外加松香时，注意控制松香用量，减少松香和锡渣飞溅；
3. 为防止飞溅物溅落到封装胶上金属圈上贴有保护膜，焊接前请检查模块的保护膜是否完好。



HOPE MICROELECTRONICS CO.,LTD
Add: 2/F, Building 3, Pingshan Private
Enterprise Science and Technology Park,
Lishan Road, XiLi Town, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, China
Tel: +86 755 82973805
Fax: +86 755 82973550
Email: sales@hoperf.com
Website: <http://www.hoperf.com>
<http://www.hoperf.cn>

This document may contain preliminary information and is subject to change by Hope Microelectronics without notice. Hope Microelectronics assumes no responsibility or liability for any use of the information contained herein. Nothing in this document shall operate as an express or implied license or indemnity under the intellectual property rights of Hope Microelectronics or third parties. The products described in this document are not intended for use in implantation or other direct life support applications where malfunction may result in the direct physical harm or injury to persons. NO WARRANTIES OF ANY KIND, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE OFFERED IN THIS DOCUMENT.

©2013, HOPE MICROELECTRONICS CO.,LTD. All rights reserved.
Rev:Soldering Note_EN_V2.0